

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2021-049

# 深圳丹邦科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，且同时出具了否定意见的内部控制评价报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	丹邦科技	股票代码	002618
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢凡（代）	李志福	
办公地址	广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼	广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼	
电话	0755-26511518、0755-26981518	0755-26511518、0755-26981518	
电子信箱	dongmiban@danbang.com	dongmiban@danbang.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业，包括FPC、COF柔性封装基板、COF产品及关键配套材料聚酰亚胺薄膜（PI膜）的研发、生产与销售。

#### （一）主要业务

##### 1、FPC、COF柔性封装基板及COF产品

FPC（Flexible Printed Circuit Board）即柔性印制电路板，是连接电子零件用的基板和电子产品信号传输的媒介。COF柔性封装基板作为FPC的高端分支产品，指还未装联上芯片、元器件的封装型柔性基板，在芯片封装过程中，起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的作用，特别是对芯片起到物理保护、提高信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力缓和、散热防潮的作用。COF产品（Chip on flexible printed circuit）是用COF柔性封装基板作载体，将半导体芯片直接封装在柔性基板上形成的芯片封装产品。公司致力于在微电子领域为客户提供全面的柔性互连解决方案及基于柔性基板技术的芯片封装方案。公司FPC、COF柔性封装基板及COF产品具有配线密度高、厚度薄、重量轻、配线空间限制少、可折叠、灵活度高等优点，适用于空间狭小、可移动、可折叠的各类高精尖智能终端产品，在消费电子、医疗器械、特种计算机、智能显示、高端装备产业等微电子领域都得到广泛应用。

## 2、聚酰亚胺薄膜（PI膜）

聚酰亚胺薄膜（PI膜）是一种新型的耐高温有机聚合物薄膜，按照用途分为一般绝缘和耐热为主要性能指标的电工级和赋有高挠性、低膨胀系数等性能的电子级。用于电子信息产品中的电子级PI薄膜作为特种工程材料具有其他高分子材料所无法比拟的高耐热/氧性能、优良的机械性能、电性能及化学稳定性，被称为“黄金薄膜”。微电子级PI膜最大的应用市场是作为柔性印制电路板（FPC）的基板材料—挠性覆铜板（FCCL）用重要的绝缘基材，同时，也是PI膜深加工产品的前驱体材料。公司生产的高性能微电子级PI膜产品介电强度、热/吸湿膨胀系数、拉伸强度等指标达到或优于国际同类产品水平，可应用于挠性印制电路板领域、绝缘材料领域、半导体及微电子工业领域、非晶硅太阳能电池领域等。

### （二）主要经营模式及主要业绩驱动因素

公司主要经营模式为以销定产，直销和经销相结合。公司在深化与现有客户良好合作的基础上，积极拓展国内外市场，持续提升公司核心竞争力，同时继续沿着公司产业链延伸，拓宽PI膜应用领域。不断丰富产品结构、持续提升产品技术水平以响应市场变化与客户需求的能力，是公司当前及未来重要的业绩驱动因素。

### （三）行业情况

柔性印制电路板需求由下游终端电子产品需求所主导。全球柔性印制电路板行业近年来保持较快发展，其中，智能手机、平板电脑、车载电子等移动电子设备为首的消费类电子产品更新换代，AR/VR/可穿戴智能设备、消费级无人机等电子产品兴起和发展，汽车电子化、无线充电以及柔性OLED显示屏等产品市场增长；5G趋近商用也助力了高频FPC的发展；同时，各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得FPC借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入广阔的应用空间。

微电子级PI膜主要应用于FCCL的制造及作为PI膜深加工产品的前驱体材料。微电子级PI膜及其深加工产品具有广阔的应用前景和巨大的商业价值，是微电子封装领域关键的配套材料，在微电子封装技术发展进程中具有决定性的作用和重要的基础地位、先行地位和制约地位。随着PI膜的技术发展，微电子级PI膜及其深加工产品的性能不断提升，其应用范围内也在不断扩大，如用于散热材料、光电显示材料、新能源材料等。目前PI膜及其深加工产品已经被广泛应用于消费电子、新型显示、新能源等多个领域，受益于下游行业的蓬勃发展，微电子级PI膜及其深加工产品的市场前景广阔。

公司成立以来，专注于柔性印制电路及新型功能性高分子材料的研发，在柔性印制电路板及电子级PI膜领域深耕近二十年。公司的行业地位突出，先后承担并完成了两项国家“863计划”重大研究课题、两项国家科技重大专项项目（02专项）和多项国家级、省市级科技攻关项目。公司在柔性印制电路板及PI膜领域具有深厚的技术积累，取得多项创新成果，获得四十余项国家发明专利和国际专利。公司坚持实施高端产品竞争战略，通过多年的技术创新和市场开拓，已经形成较为完整的产业链和合理的产品结构，是全球极少数掌握微电子级PI膜、高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	48,724,451.45	347,148,108.89	-85.96%	343,586,590.45
归属于上市公司股东的净利润	-811,050,121.78	17,335,035.40	-4,778.68%	25,415,213.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-814,429,736.57	10,977,915.49	-7,518.80%	17,187,687.53
经营活动产生的现金流量净额	14,679,083.40	155,676,523.06	-90.57%	213,484,373.76
基本每股收益（元/股）	-1.48	0.03	-5,033.33%	0.05
稀释每股收益（元/股）	-1.48	0.03	-5,033.33%	0.05
加权平均净资产收益率	-60.99%	1.01%	-62.00%	1.40%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,749,887,310.89	2,492,634,263.05	-29.80%	2,419,192,948.17
归属于上市公司股东的净资产	915,387,835.41	1,735,360,272.32	-47.25%	1,715,897,669.55

### （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	45,751,204.35	88,895,649.73	107,093,331.78	-193,015,734.41
归属于上市公司股东的净利润	-4,598,917.08	5,734,879.18	-6,249,426.36	-805,936,657.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,612,411.47	4,733,825.23	-7,025,312.59	-806,525,837.74
经营活动产生的现金流量净额	7,226,476.05	3,348,950.32	102,578,597.81	-98,474,940.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

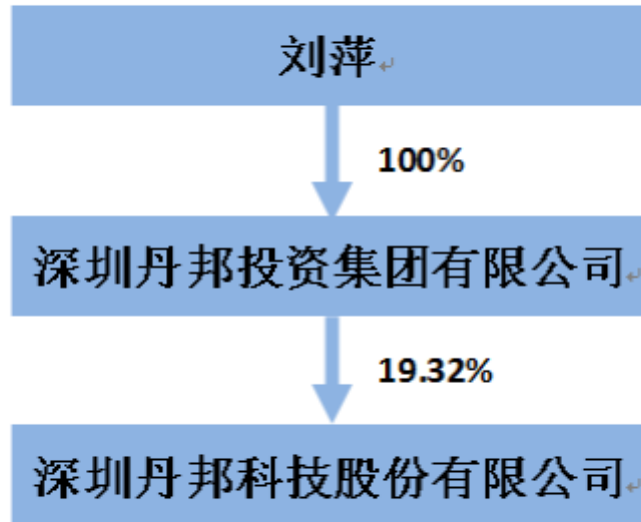
报告期末普通股股东总数	45,657	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	19.32%	105,884,000		质押	50,000,000	
深圳市丹依科技有限公司	境内非国有法人	6.18%	33,835,053		冻结	33,835,053	
张淑娟	境内自然人	1.53%	8,361,400				
林培	境内自然人	0.98%	5,350,000				
郝昕	境内自然人	0.64%	3,500,000				
杨阳	境内自然人	0.49%	2,680,900				
吴沛霖	境内自然人	0.47%	2,552,556				
陈俊杰	境内自然人	0.42%	2,321,900				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	2,144,829				
汪涓	境内自然人	0.37%	2,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法定代表人刘萍与深圳市丹依科技有限公司主要股东刘文魁为叔侄关系；2、除此之外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中，深圳丹邦投资集团有限公司通过信用证券账户持有 30,000,000 股；林培通过信用证券账户持有 1,500,000 股；陈俊杰通过信用账户持有 1,427,600 股。						

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

2020年，全球经济受突如其来的新冠疫情冲击，国内外形势依然复杂严峻，同时，受制于人民币处于币值高位、现金流缺口、公司债务逾期和供应商诉讼，公司业务经营受到前所未有的挑战，一方面在自身内部制定有效的经营措施，另一方面，公司开始和债权人、银行进行协商，从而改善公司面临的困局。

报告期内，公司实现营业收入48,724,451.45元，同比下降85.96%；营业利润-805,313,692.37元，同比下降5,003.68%；归属上市公司净利润-811,050,121.78元，同比下降4,778.68%；截止至2020年12月31日，公司资产合计1,749,887,310.89元，同比下降29.80%；所有者权益合计915,387,835.41元，同比下降47.25%；归属于上市公司股东的每股净资产1.67元，同比下降47.25%。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
FPC	41,210,934.02	-40,170,109.82	-97.60%	-87.97%	-58.68%	-140.33%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

1. 受全球新冠肺炎疫情影响，公司销售业绩出现下滑。
2. 公司出于谨慎性原则，对于存在2年以上应收账款未能收回的计提坏账损失，导致信用减值损失增加，净利润减少。
3. 公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度拟计提资产减值准备，导致净利润减少。

#### 6、面临退市情况

适用  不适用

公司2020年经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1第（一）项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形。

#### 7、涉及财务报告的相关事项

##### （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

详见本报告“第十二节 财务报告”-“五、重要会计政策及会计估计”-44、重要会计政策和会计估计变更

##### （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

##### （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。